



关于上海晶丰明源半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的
审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）



二〇一九年七月

上海证券交易所：

贵所出具的《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核中心意见落实函》（上证科审（审核）〔2019〕382号）（以下简称“《意见落实函》”）已收悉，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）、上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“发行人”、“晶丰明源”）、国浩律师（杭州）事务所（以下简称“发行人律师”）等相关方对意见落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

除另有说明外，本回复报告所用简称与《上海晶丰明源半导体股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

意见落实函所列问题	黑体（加粗）
意见落实函所列问题的回复	宋体（不加粗）、 楷体（加粗）
中介机构核查意见	宋体（不加粗）

目录

问题一	4
问题二	5
问题三	9
问题四	10
问题五	17

问题一

请发行人补充披露 2019 年半年度未审财务信息和报告期内关键审计事项。

回复：

【补充信息披露情况】

（一）2019 年上半年主要经营情况

2019 年 1-6 月，公司未经审计的主要经营成果变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月	变动幅度
营业收入	41,123.08	37,770.47	8.88%
毛利率	22.92%	22.61%	0.31 个百分点
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	4,116.83	3,854.73	6.80%

注：上述 2019 年上半年财务数据为公司初步核算数据，未经会计师审计或审阅。

根据未经审计数据，2019 年 1-6 月，公司实现营业收入 41,123.08 万元，较上年同期增长 8.88%；2019 年 1-6 月，公司毛利率为 22.92%，与上年同期基本持平；2019 年 1-6 月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 4,116.83 万元，较上年同期增长 6.80%。

综上，2019 年 1-6 月公司经营情况良好，营业收入及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均有所增长，毛利率基本稳定，具备良好的盈利能力，不存在异常或重大不利变化。

上述楷体加粗内容发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“（五）2019 年上半年主要经营情况”中补充披露。

（二）报告期内关键审计事项

关键审计事项是会计师根据职业判断，认为分别对 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并

形成审计意见为背景，会计师不对这些事项单独发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA10540 号）中，对关键审计事项的描述具体如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
营业收入确认	
<p>晶丰明源的产品主要采用经销商买断销售的销售模式。</p> <p>2017 年度，公司营业收入中经销产生的收入为 55,094.94 万元，占主营业务收入的比例为 79.36%；</p> <p>2018 年度，公司营业收入中经销产生的收入为 55,979.52 万元，占主营业务收入的比例为 73.09%。</p> <p>在经销商模式下，公司管理层为了达到特定目标或期望，存在通过经销商调节收入的可能性，故收入确认存在重大错报的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 评价与收入确认相关的关键内部控制，测试内部控制是否一贯有效执行；</p> <p>(2) 结合产品类型对销售单价及毛利率情况进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(3) 从销售收入的会计记录和出库记录中选取样本，与该笔销售相关的订单、发货单及物流记录进行核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间；</p> <p>(4) 获取经销商存货库存统计，分析年末尚未出售的存货是否处于合理水平，并针对经销商年末尚未出售的存货，选取经销商执行函证程序、现场监盘程序；</p> <p>(5) 获取期后销售收入的会计记录和出库记录，检查期后是否存在异常退货。</p>

上述楷体加粗内容发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“四、审计意见及关键审计事项”之“(二) 关键审计事项”中补充披露。

问题二

请保荐机构和发行人律师结合股权代持期间发行人分红和分红款支付情况，进一步说明发行人股权代持的真实性，并发表核查意见。

回复：

【说明与分析】

(一) 股权代持期间的分红概述

1、根据发行人提供的股权激励及相关委托持股法律文件、财务凭证及相关审计

报告和财务报表、晶丰有限分红股东会决议，并经保荐机构核查对发行人实际控制人、实际出资人的访谈及其出具的确认函确认，在 2012 年 5 月上海晶哲瑞设立前，实际出资人通过委托发行人实际控制人之一胡黎强持有晶丰有限股权。根据发行人实际控制人、财务负责人说明并经核查公司财务报表，该期间内晶丰有限未进行分红，因此，被代持人未取得过相应分红款。

针对该期间内的委托持股情况，保荐机构核查了相关委托持股协议、出资款项凭证及解除委托持股的相关法律文件，并对发行人实际控制人、被代持人进行了访谈，该期间内被代持人均真实出资，股权代持情况真实存在。

2、2012 年 5 月上海晶哲瑞设立后，实际出资人均以委托发行人实际控制人之一刘洁茜持有上海晶哲瑞出资份额方式，间接持有晶丰有限股权。

同时，根据发行人及其实际控制人的说明、发行人提供的财务凭证及相关审计报告和财务报表、晶丰有限分红股东会决议并经核查，晶丰有限自 2013 年 5 月开始进行分红。因此，该期间内被代持人取得的分红，均由上海晶哲瑞合伙人刘洁茜作为受托持股人予以支付。该等分红过程及分红金额进一步印证了该期间内股权代持情况真实存在。

（二）股权代持期间的分红具体情况

根据发行人及其实际控制人的说明、发行人提供的财务凭证及相关审计报告和财务报表、晶丰有限分红股东会决议，2012 年 5 月上海晶哲瑞设立至 2017 年 1 月委托持股规范、清理完毕期间，上海晶哲瑞累计实施了 5 次现金分红，累计分红金额为 3,307.54 万元。被代持人根据其持有上海晶哲瑞权益比例所享有的分红，由代持受托人刘洁茜以银行转账方式分配。该等分红过程及分红金额进一步印证了公司过往存在的股权代持关系。

委托持股期间，上海晶哲瑞分红的具体情况如下：

（1）2013 年分红

2013 年 6-7 月，上海晶哲瑞现金分红 220.00 万元，上海晶哲瑞全体实际权益人

按照出资份额占比获得分红。本次分红时，涉及 16 名被代持人委托刘洁茜持股，所持上海晶哲瑞出资份额比例合计为 43.14%；据此计算，其本次应获得分红 94.91 万元（分红金额按四舍五入计算，下同）。剩余 125.09 万元由上海晶哲瑞的实际权益人刘洁茜、胡黎强按其持股比例参与分配。

经核查，前述 16 人实际获得分红金额 94.91 万元，实际分红金额与应获分红金额一致，且被代持人均按照其当时所持上海晶哲瑞权益比例参与分红。

（2）2014 年分红

2014 年 4-6 月，上海晶哲瑞现金分红 621.60 万元，上海晶哲瑞全体实际权益人按照出资份额占比获得分红。本次分红时，涉及 18 名被代持人委托刘洁茜持股，所持上海晶哲瑞出资份额比例合计为 50.11%；据此计算，其本次应获得分红 311.47 万元。剩余 310.13 万元由上海晶哲瑞的实际权益人刘洁茜、胡黎强按其持股比例参与分配。

经核查，前述 18 人实际获得分红金额 311.47 万元，实际分红金额与应获分红金额一致，且被代持人均按照其当时所持上海晶哲瑞权益比例参与分红。

（3）2015 年分红

2015 年 3-4 月，上海晶哲瑞现金分红 688.73 万元，上海晶哲瑞全体实际权益人按照出资份额占比获得分红。本次分红时，涉及 16 名被代持人委托刘洁茜持股，所持上海晶哲瑞出资份额比例合计为 34.95%，按其持股比例合计分红 240.68 万元；剩余 448.05 万元由上海晶哲瑞的实际权益人刘洁茜、胡黎强按其持股比例参与分配。

经核查，前述 16 人实际获得分红金额 240.68 万元，实际分红金额与应获分红金额一致，且被代持人均按照其当时所持上海晶哲瑞权益比例参与分红。

（4）2016 年第一次分红

2016 年 3 月，上海晶哲瑞现金分红 393.57 万元，上海晶哲瑞全体实际权益人按照出资份额占比获得分红。本次分红时，涉及 20 名被代持人委托刘洁茜持股，所持上海晶哲瑞出资份额比例合计为 35.56%，按其持股比例合计分红 139.97 万元；剩

余 253.60 万元由上海晶哲瑞的实际权益人刘洁茜、胡黎强按其持股比例参与分配。

经核查，前述 20 人实际获得分红金额 139.97 万元，实际分红金额与应获分红金额一致，且被代持人均按照其当时所持上海晶哲瑞权益比例参与分红。

（5）2016 年第二次分红

2016 年 12 月，上海晶哲瑞现金分红 1,385.34 万元，上海晶哲瑞全体实际权益人按照出资份额占比获得分红。本次分红时，涉及 15 名被代持人委托刘洁茜持股，所持上海晶哲瑞出资份额比例合计 25.28%，按其持股比例合计分红 350.27 万元；剩余 1,035.07 万元由上海晶哲瑞的实际权益人刘洁茜、胡黎强按其持股比例参与分配。

经核查，前述 15 人实际获得分红金额 350.27 万元，实际分红金额与应获分红金额一致，且被代持人均按照其当时所持上海晶哲瑞权益比例参与分红。

综上所述，保荐机构及发行人律师认为：（1）发行人（晶丰有限）历史上委托持股期间，被代持人真实出资，并按照签署的代持协议享有分红等股东权益；自 2012 年 5 月上海晶哲瑞设立至 2017 年 1 月委托持股规范、清理完毕期间，被代持人取得的相应分红款项与其持股比例一致。据此，被代持人的股权代持情况真实存在；（2）截至 2017 年 1 月发行人整体变更为股份有限公司前，发行人（晶丰有限）过往存在的代持关系均已解除，解除过程合法、有效，该等事宜不会对发行人本次发行并在科创板上市构成实质性障碍。

【中介机构核查意见】

（一）核查过程

保荐机构、发行人律师核查过程如下：

1、获取了发行人提供的股权激励及相关委托持股法律文件、财务凭证及相关审计报告和财务报表、晶丰有限分红股东会决议，取得了发行人实际控制人、实际出资人的访谈及其出具的确认函，核查发行人委托持股期间分红情况以及委托持股情况；

2、查阅了发行人以及相关股东提供的分红相关的银行流水及转账凭证，与相关被代持股东的代持协议等资料相关股权比例核对，确认分红情况是否与分红时委托持股比例相匹配。

（二）核查结论

保荐机构及发行人律师认为：（1）发行人（晶丰有限）历史上委托持股期间，被代持人真实出资，并按照签署的代持协议享有分红等股东权益；自2012年5月上海晶哲瑞设立至2017年1月委托持股规范、清理完毕期间，被代持人取得的相应分红款项与其持股比例一致。据此，被代持人的股权代持情况真实存在；（2）截至2017年1月发行人整体变更为股份有限公司前，发行人（晶丰有限）过往存在的代持关系均已解除，解除过程合法、有效，该等事宜不会对发行人本次发行并在科创板上市构成实质性障碍。

问题三

请发行人就募集资金到位后资产规模迅速扩张可能引发的经营和管理风险作风险提示。

回复：

【补充信息披露情况】

公司通过多年的持续发展，已建立了比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系。但随着公司主营业务的不断拓展、产品结构的逐步优化，公司资产规模、业务规模等都将持续扩大，在生产经营管理、技术开发、市场开拓、内外部资源整合等方面对公司均提出更高的要求，公司经营活动、组织架构和管理体系亦将趋于复杂。尤其是本次公开发行募集资金投资项目实施后，公司将进入一个新的发展阶段，对公司的经营和管理有了更高的要求。如果公司的经营理念、管理体系未能适应公司发展的要求，将会对公司的经营效率和管理能力产生不利影响影

响，难以保证公司盈利水平与经营规模同步增长。

上述楷体加粗内容发行人已在招股说明书“第四节 风险因素”之“六、其他风险”之“（一）募集资金投资项目风险”部分补充披露“4、公司募集资金到位后经营和管理风险”。

问题四

请发行人进一步说明招股说明书有关行业地位、技术先进性中“行业领先”“国内领先”“国际领先”等表述是否准确，依据是否充分，相关披露是否符合实际情况。请保荐机构发表核查意见。

回复：

【说明与分析】

招股说明书中关于公司“行业领先”的相关论述主要包括公司具有行业领先的技术及行业领先的市场地位。针对公司技术先进性，公司分别将技术及产品与国内相似产品、技术及境外相似产品、技术进行了对比，并得到相关产品及技术“国内领先”及“国际领先”的结论，上述结论依据充分、表述准确，符合公司及所在行业的实际情况。具体分析如下：

（一）公司具有“行业领先”的技术实力的依据

1、在 LED 照明驱动芯片领域具有领先地位、产品性能指标行业领先

公司主要产品包括 LED 照明驱动芯片及电机驱动芯片。目前公司 LED 照明驱动芯片领域的主要竞争对手为 A 股上市公司士兰微、以及境外上市公司矽力杰；公司 LED 照明驱动芯片在主要技术参数等性能指标上已经达到或者超过主要竞争对手，处于行业领先地位，具体情况如下：

公司通用 LED 照明驱动芯片产品主要竞争对手为士兰微，公司通用 LED 照明

驱动芯片产品及相关技术参数与士兰微比较情况如下：

士兰微技术参数及描述	公司技术参数及描述	差异情况
“系列产品采用士兰微电子自有的先进工艺，集成650V 高压功率 MOS 管”	公司主要产品均采用了700V-BCD 高压集成工艺技术。	根据产品需求，采用不同级别的高压功率 MOS 器件。高压功率管主要用于大功率的功率输出，其性能对整个内部电路的工作和安全至关重要，公司掌握了700V-BCD 高压集成工艺。
“系列产品做到了功率段更加细化，根据不同封装，功率段可以分别做到7W、9W、15W、18W 和 24W。”	公司产品功率段覆盖了3W、5W、7W、9W、15W、18W、24W 和 30W、50W、100W。	功率段范围越广，代表产品应用更为丰富。
“使用了士兰微电子的闭环控制专利技术，从而省去了 COMP 端外围补偿元器件”	公司掌握的过温闭环控制降电流核心技术，除省去 COMP 端外围补偿元器件，同时可省去 VCC 电容等外围元器件。	节省外围元器件有利于终端客户优化照明产品整体成本。节省外围元器件需要芯片具有更高的集成度以及相应设计优化。
“在加补偿条件下，全电压输入 THD 小于 10%”	无需外部补偿电路设计，公司全电压输入 THD 小于 15%。	THD（总谐波失真）表示正常电流波形的一种失真。印度等国家设定 THD 指标不高于 15% 的标准。公司在非补偿条件下，即可以满足该等国家对于 THD 指标的相关要求。无需外部补偿电路，在成本上具有优势。
“产品可兼容 PWM 和模拟两种调光方式，调光深度可达 2.5%”	公司掌握的无频闪无噪声数模混合无级调光核心技术，运用了 1% 深度调光技术。	调光深度是智能 LED 照明产品的重要技术指标之一，调光深度越小，表明对在保持恒流的基础上芯片对电流控制更为精确。因此，调光深度越小，其技术难度越高。

注：上述士兰微产品技术参数及指标来自于其官网 2019 年 4 月 17 日《士兰微电子推出 SD682X/SD689X/SD7880 多系列产品》。

公司智能 LED 照明驱动芯片产品主要竞争对手为矽力杰，公司智能 LED 照明驱动芯片与主要竞争对手矽力杰竞品主要技术指标对比详细情况参见下表：

技术指标	晶丰明源产品 A	矽力杰产品 B	备注
调光深度	1%	5%	调光低亮度一致性是指批量生产时，每个灯泡调光到低亮度的偏差，一致性偏差越小，各灯泡的亮度越接近，其技术难度越高。
调光低亮度一致性	3% ±0.6%	5% ±1%	调光低亮度一致性是指批量生产时，每个灯泡调光到低亮度的偏差，一致性偏差越小，各灯泡的亮度越接近，其技术难度越高。
调光闪烁点	无	无	一致
待机功耗	3 毫瓦 @120Vac 6 毫瓦 @230Vac	35 毫瓦 @120Vac 65 毫瓦 @230Vac	待机功耗是指灯泡通过遥控关机，处于待机模式等待下次唤醒的过程中，消耗

			的功率。待机功耗越低，越节能环保，其技术难度越高。
启动时间	150ms @120Vac 130ms @230Vac	700ms @120Vac 460ms @230Vac	启动时间是指灯泡上电后，到灯泡输出电流和亮度建立的延迟时间。时间越短，用户的体验越好，其技术难度越高。
外围成本和体积	单绕组电感；高压启动，无需启动电阻	双绕组变压器及采样电阻；2个1206VCC启动电阻	芯片外围越简单，对客户来说成本越低，体积越小，生产效率也越高。

注：上述数据来源来自于矽力杰产品技术手册或公司实验室数据。

以上对比表明，公司在部分技术指标上领先行业主要竞争对手，公司上述竞争对手均为行业内知名集成电路芯片企业，在产品技术、性能等方面具有一定的行业领先性，公司与该等竞争对手相比具有一定的技术优势，体现了公司技术的国际领先性。

2、公司电源管理芯片领域技术储备处于领先地位

公司掌握的电源管理芯片设计技术可广泛应用于智能照明、智能面板、智能家居等领域，公司为国内较早布局电机驱动芯片领域的芯片供应商之一，在智能照明、智能面板、智能家居、电机驱动领域具有领先的技术储备。

智能照明、智能面板、智能家居相关产品需要实现 24 小时不间断待机状态，因此对电源管理芯片的待机功耗要求较高，待机功耗对芯片设计技术要求较高。公司推出的应用于智能照明产品的 BP8519C 芯片可以在使用蓝牙和 ZigBee 的无线芯片负载情况下，能够做到 0.2W 以下的待机功耗，得到 GE、飞利浦、宜家、小米、得邦、阳光等国内外知名品牌客户的广泛使用。公司 2019 年推出的应用于智能照明产品的 BP2525D 芯片，在 WiFi 无线芯片负载情况下，能够实现 0.2W 以下的待机功耗，目前该等技术处于国际领先水平。公司 2019 年推出的应用于智能面板的 AC/DC 电源管理芯片，空载待机功耗更是可以做到 2 毫瓦以下，远远优于美国 PI (Power Integrations) 等国际知名电源管理芯片厂商公司 5 毫瓦待机功耗的水平，目前是少数可以满足 GE、公牛等客户要求的单火线智能面板 AC/DC 电源管理芯片，处于国际领先地位。公司申请了低功耗技术相关的“电源电路、芯片、智能开关及电源供电方法”、“开关控制电路、智能开关及开关控制方法”等多项专利。

电机驱动芯片在技术复杂度、工艺要求、封装技术等方面具有更高的技术要求，

具有很高的技术难度及技术门槛。公司是国内少数开展电机驱动芯片研发的企业之一。公司储备了“无刷直流电机相位控制电路及控制方法”、“无刷直流电机的模拟闭环调速装置及其方法”、“电机转子位置信号的自适应处理方法;装置和控制系统”、“无刷电机相位超前角优化的方法、装置和控制系统”等技术。根据王阳元院士主编的《集成电路产业全书》，目前国际上主流的半导体厂商均有完备的电动机控制解决方案，如 TI（德州仪器）、ST（意法半导体）、Allegro MicroSystems，中国研究电动机控制集成电路的企业主要有晶丰明源、士兰微等少数几家企业，公司电机驱动芯片处于国内领先水平。

3、公司技术获得了相关政府机构、行业协会等单位的广泛认可

公司自成立以来即注重集成电路行业技术的研发升级、持续保持产品技术创新。公司可控硅调光发光二极管驱动芯片产品荣获中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合评选的“第十一届（2016年度）中国半导体创新产品和技术”荣誉。公司通过产学研模式开发的功率高压 MOS 器件关键技术与应用技术于 2017 年荣获“四川省科技进步奖一等奖”，该等研发成果于 2019 年获得教育部向国家科学技术奖励工作办公室提名申请“国家科技进步奖”。

公司自成立以来，始终重视技术创新，曾经获得“上海市专利工作试点企业”、“上海科技企业创新奖”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市“专精特新”中小企业”等多项荣誉，多个项目被上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定为上海市高新技术成果转化项目。其中，2018 年公司“优化线电压补偿的线性 LED 驱动芯片（BP51 型/BP522 型/BP56 型/BP5818 型）”、“非隔离外置开路保护 LED 驱动芯片（BP283 型/BP285 型/BP286 型/BP983 型）”、“无 VCC 电容 LED 驱动芯片（BP316 型/BP289 型/BP993）”、“非隔离 500V 高压集成工艺单芯片（BP991 型/BP992 型）”、“总谐波优化高功率因数驱动芯片（BP23 型/BP260 型/BP31 型/BP323 型/BP33 型）”等 5 个项目被认定为上海市高新技术成果转化项目。

此外，公司是国内最早实现 LED 照明驱动芯片技术突破的企业，始终保持在

LED 照明驱动芯片领域的行业领先性。在我国半导体照明产业发展的初期，照明驱动芯片主要依靠进口，公司是国内率先设计出 LED 照明驱动芯片并进行商业化的企业。公司也因此获得了中国照明学会、半导体照明技术应用专业委员会颁发的“中国 LED 首创奖”等荣誉称号。公司共取得了 13 项上海市高新技术成果转化项目荣誉。此外，根据国家科技部主管核心期刊《电子产品世界》文章《LED 照明需要本土芯片》所述，公司 BP2325 系列实现了功率校正功能，是业界第一款此功能产品，提升了产品稳定性；BP2831 系列是业界首创的在降压拓扑上用单绕组实现过压保护功能，提升了产品可靠性。

（二）公司具有“行业领先”的市场地位的依据

1、公司主要产品市场占有率领先

根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）统计，2018 年国内 LED 照明产品产量约为 135 亿套，按照每只 LED 照明产品通常配套一颗 LED 照明驱动芯片测算，公司 2018 年境内销量为 38.18 亿粒（包含未封测晶圆折算粒数），公司 2018 年市场占有率为 28.28%。报告期内，公司市场占有率保持在较高水平，为少数行业内具有领先市场地位的企业之一，公司在 LED 照明驱动芯片领域具有国际领先性。

2、公司具有广泛客户基础，获得了行业普遍认可

我国已成为 LED 照明全球主要的生产国家，全球 LED 照明产能主要集中于飞利浦等国际厂商以及我国欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等境内照明企业。该等大型 LED 照明企业产品型号较多、销售区域较为广泛，引致对其 LED 照明芯片供应商在技术稳定性、多样性、创新性等方面具有较高的要求。

公司与国内外主要的照明产品供应商如飞利浦、欧普照明、雷士照明、阳光照明、三雄极光、佛山照明、得邦照明等均建立了长期的合作关系，2016 年及 2017 年“中国 LED 照明产品出口十强企业”共 13 家大型照明企业全部配套应用了公司 LED 照明驱动芯片。由于该等照明厂商具有较高的驱动芯片供应商准入门槛且产品远销世界各地技术规格性能要求较高，因此公司 LED 照明驱动产品获得了下游客终

端客户的广泛认可。

公司在智能照明领域的技术积累获得行业的普遍认可，国际照明领导品牌飞利浦在其推出的首款智能照明产品—HUE 照明系统中全面配套使用公司为其定制化设计的智能电源驱动芯片，公司进一步加强市场开拓，与天猫、小米等新晋互联网厂商展开合作。

3、公司在 LED 照明、电机驱动等细分领域具有行业领先地位

公司是国内最早实现 LED 照明驱动芯片技术突破的企业，根据国家科技部主管核心期刊《电子产品世界》文章《LED 照明需要本土芯片》所述，公司 BP2325 系列实现了功率校正功能，是业界第一款此功能产品，提升了产品稳定性；BP2831 系列是业界首创的在降压拓扑上用单绕组实现过压保护功能，提升了产品可靠性。公司获得了中国照明学会、半导体照明技术应用专业委员会颁发的“中国 LED 首创奖”等荣誉称号。

公司是国内少数开展电机驱动芯片研发的企业之一。电机驱动芯片主要应用于家用电器、新能源、工业控制等工业领域。由于工业控制领域需要高可靠性、高性能驱动芯片以承载马达、电机工作负荷，因此承受瞬间高压电压突变的能力成为工业控制用电源管理驱动芯片的重要技术门槛。根据王阳元院士主编的《集成电路产业全书》，目前国际上主流的半导体厂商均有完备的电动机控制解决方案，如 TI（德州仪器）、ST（意法半导体）、Allegro MicroSystems，中国研究电动机控制集成电路的企业主要有晶丰明源、士兰微等少数几家企业，公司电机驱动芯片处于国内领先水平。

4、公司行业地位获得政府部门、行业协会等单位的广泛认可

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有相关的国际专利 4 项，国内专利 149 项，其中发明专利 54 项，公司拥有与主营业务相关的集成电路布图设计专有权 105 项。公司行业地位获得政府部门、行业协会，具体如下表所示：

序号	证书/奖励名称	证书编号/ 项目名称	颁发 时间	颁发机构
----	---------	---------------	----------	------

1	2018 年度上海市集成电路设计企业销售前十名	-	2019.04	上海市集成电路行业协会
2	2017 年度上海市集成电路设计企业销售前十名	-	2018.04	上海市集成电路行业协会
3	2016 年度上海市集成电路设计企业销售前十名	-	2017.04	上海市集成电路行业协会
4	第十一届（2016 年度）中国半导体创新产品和技术	-	2017.03	中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社
5	四川省科学技术进步奖	2016-J-1-09-D04	2017.04	四川省人民政府
6	2016 中国 LED 首创奖	-	2016.04	中国照明学会、半导体照明技术应用专业委员会
7	上海市“专精特新”中小企业	-	2017.12	上海市经济和信息化委员会
8	上海科技企业创新奖	-	2016.09	上海市科技企业联合会
9	2014-2016 年度浦东新区集成电路设计业亮点企业(成长性)	-	2016.09	上海市浦东新区国民经济和社会信息化推进中心
10	上海市科技小巨人企业	-	2015	上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会

综上所述，公司在 LED 照明驱动芯片领域具有国际领先的先进技术、产品性能指标行业领先，公司电源管理芯片领域技术储备处于领先地位，公司技术获得了相关政府机构、行业协会、终端客户等单位的广泛认可。公司在 LED 照明驱动芯片领域具有领先市场占有率，公司具有广泛客户基础，获得了行业普遍认可，公司在 LED 照明、电机驱动等细分领域具有行业领先地位，公司行业地位获得政府部门、行业协会等单位的广泛认可。

因此，公司关于行业地位、技术先进等领先性的相关表述主要基于行业研究报告、学术文章、获得的荣誉奖项及同行业公司公开信息综合判断，公司技术领先性、行业地位领先性的相关表述准确，依据充分，符合公司实际情况。

【中介机构核查意见】

（一）核查过程

保荐机构核查过程如下：

1、保荐机构查阅了发行人所处行业的公开研究报告等行业相关资料，访谈了发

行人实际控制人、技术人员以及发行人下游主要客户，获取了发行人技术特点、行业地位、技术发展情况相关资料；

2、保荐机构查阅了发行人所处行业的专业技术资料及公开论文等，对行业技术发展特征、产品应用领域等方面进行对比分析；

3、通过同行业公司的招股说明书、年报、网站信息等公开材料，对比了同行业竞争对手的业务内容，技术资料，结合集成电路行业的发展及基本情况，对比了发行人与同行业主要技术在行业内的发展情况，获取了发行人竞争对手相关产品技术资料等。

（二）核查结论

保荐机构认为：发行人关于行业地位、技术先进等领先性的相关表述主要基于行业研究报告、学术文章、获得的荣誉奖项及同行业公司公开信息综合判断，公司技术领先性、行业地位领先性的表述准确，依据充分，相关披露符合发行人实际情况。

问题五

请发行人、控股股东和实际控制人按照有关规定补充完善欺诈发行购回承诺。

回复：

【补充信息披露情况】

1、发行人关于欺诈发行股份购回承诺事项如下：

(1) 保证本公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，

购回本公司本次公开发行的全部新股。

2、发行人控股股东胡黎强以及发行人实际控制人胡黎强和刘洁茜关于欺诈发行股份购回承诺事项如下：

(1) 本人保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形。

(2) 如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。

上述楷体加粗内容发行人已在招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心技术人员以及保荐人、证券服务机构作出的重要承诺及其履行情况和约束措施”之“(四)关于欺诈发行上市的股份购回的承诺”部分补充披露。

【本页无正文，专用于上海晶丰明源半导体股份有限公司《关于上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核中心意见落实函的回复》之签字盖章页】

上海晶丰明源半导体股份有限公司

法定代表人：



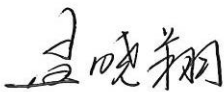


胡黎强

2019年7月11日

【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市审核中心意见落实函的回复》之签字盖章页】

保荐代表人：



孟晓翔



林文坛



广发证券股份有限公司

2019年7月11日